

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月30日
【会社名】	株式会社SUMCO
【英訳名】	SUMCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社及び当社子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社は、2021年9月30日開催の取締役会において、設備投資を実施することについて決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該事象の発生年月日

2021年9月30日（取締役会決議日）

(2) 当該事象の内容

2021年9月30日開催の取締役会において、次のとおり設備投資を実施することについて決議いたしました。

設備投資の理由

300mm半導体用シリコンウェーハの需要は堅調に拡大し、300mm半導体用最先端シリコンウェーハは現状の当社グループの製造設備では供給が需要に追いつかない状況となっております。

当社は、300mm半導体用最先端シリコンウェーハ市場における供給責任を果たすために市場の成長に見合った段階的な増産を継続して参りました。しかしながら、足許では当社グループの国内既存建屋内の増産スペースが尽きていることから、300mm半導体用最先端シリコンウェーハの段階的な増産を継続することを可能とするために、当社は新たな建屋、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資を決定いたしました。併せて当社子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社において建屋の増築、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。

設備投資の内容

- a) 対象資産の名称 300mm半導体用最先端シリコンウェーハ製造用建屋・ユーティリティ設備・製造設備
b) 所在地 佐賀県伊万里市（当社）、長崎県大村市（SUMCO TECHXIV株式会社）
c) 投資予定額 当社

建屋・ユーティリティ設備	786億円
ウェーハ製造設備	1,229億円
合計	2,015億円

SUMCO TECHXIV株式会社

建屋・ユーティリティ設備	165億円
ウェーハ製造設備	107億円
合計	272億円

- d) 資金調達方法 公募による新株式発行及び自己資金

今後の予定 2022年より建屋の建設及びユーティリティ設備の設置を進め、2023年からは製造設備を導入のうえ順次生産を開始し、2023年内にはSUMCO TECHXIV株式会社の、2024年内には当社の本設備投資の完了を予定

(3) 当該事象の損益に与える影響額

本設備投資による2021年12月期の当社個別及び連結業績に与える影響はありません。

以上